

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华创证券、中泰证券、富敦投资、华泰柏瑞基金、厦门中略投资、长城财富保险资产管理、淡水泉投资、中兴汉广投资、海南翎展私募基金、国金基金、阳光保险、招商基金、景顺长城基金、中金资管、国华兴益保险、中银国际证券、兴证证券资管、上海长见投资、兴业基金、鲍尔太平、浙商证券资管、中信保诚资管、杭州乾璐投资、长江养老保险、太平养老保险、深圳市前海恒邦兆丰资管、敦和资管、益民基金、中信建投证券、东方红资管
时间	2024年4月15日、4月18日
地点	线上电话会，公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司及市场整体概况</p> <p>根据 PrismaMark 统计，2023 年全球所有细分 PCB 产品都出现较大程度的下滑，平均下降幅度达 15%，为近二十年最大跌幅，PCB 行业相应的资本支出也有很大程度的收缩，因而对专用加工设备市场的需求影响明显。公司 2023 年营业收入同比下滑 41.34%。</p> <p>随着消费类电子市场局部回暖，加上新能源汽车电子技术升级及 AI 服务器需求强劲，相应的 PCB 产品需求增加，拉动了下游客户的资本支出，2024 年第一季度，公司实现营业收入 75,052.04 万元，同比增长 149.08%；归属于上市公司股东的净利润 6,360.12 万</p>

元，同比增长 21.49%。

二、公司新产品的布局

2023 年，公司已完成压合系统、在线双面光学检查机等新产品的研发，进一步拓展了关键工序的覆盖，加上涂层刀具产品的引入，业务范围跨入真空压合设备、光学检测设备及材料领域，为公司开拓全流程一站式场景解决方案做有力铺垫。

另外，在已布局的工序及产品方面，公司持续推动跨越性升级，如十二轴机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、应用 AOD 技术的 UV 激光钻孔机、自动上下料机械成型机、十六倍密通用高精测试机等，为 PCB 行业提供效率更高、综合成本更低的降本增效或提质增效解决方案，助力下游客户提升综合竞争力。

三、高多层板市场业务拓展情况

由于 AI 服务器、高速交换机等随着数据量的大幅攀升而采用更高层数的多层板，为确保传输数字信号的完整性，对背钻的精度要求大幅提升，公司开发的 3D 背钻技术可实现超短残桩，并可满足残桩设计值±2mil 高精度背钻的加工要求，已获得行业内多家高多层板龙头企业的认证，陆续实现正式订单；同时，大台面六倍密通用测试机及 CCD 四线测试机产品，可充分满足 CPU、GPU 区域更多更密 I/O 接口的主板对高可靠性电测的需求。

四、HDI 板市场及 IC 封装基板领域进展

面对不断提升的 HDI 技术难度，如叠层数增加、盲孔孔径减小及密度增加、高频高速材料的应用等，公司推出诸多技术升级产品，包含高转速主轴机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、UV+CO₂ 复合激光钻孔机、L/S 12/12μm 高解析度激光直接成像机、CCD 六轴独立控制机械成型机、定位精度±5μm 高精专用测试机等，并针对不同需求提供个性化的解决方案，已在国内多家知名 HDI 企业获得批量订单，产品市场占有率进一步攀升。

公司一直以来紧紧围绕国内封装基板龙头客户的需求进行产品研发，推出的高转速载板专用机械钻孔机获得国内多家龙头客户的认证，可满足 BT 载板及 FC-BGA 载板小孔径的高精度加工；创新运用新型激光技术，开发出用于玻璃基在内先进封装基板的加工方案，包括极小直径钻孔、盲槽及内埋高精度元器件锣槽等工艺的应用，广泛获得国内外封装基板厂商的技术认证及顶级终端客户的认

	<p>可；研发的封装基板高精专用测试及 FC-BGA 单片测试设备，具备对标龙头企业 Nidec-Read 主流机型的能力。</p> <p>五、海外市场情况</p> <p>公司在韩国、日本、中国台湾及泰国等国际电子展会频频亮相，公司创新型产品及解决方案得到广泛的推广，2023 年海外业务营业收入同比增长 140%。公司品牌海外知名度有所提升，已与从中国大陆出海到东南亚国家的多家 PCB 企业达成合作意向，随着下游客户东南亚项目的陆续落地，公司产品的销售量有望显著增长；另外，东南亚地区新增投资项目的 PCB 产品类型主要包括传统多层板及中低阶 HDI，对压合系统、机械钻孔机、CO₂ 激光钻孔机、激光直接成像机、通用测试机及高精专用测试等多品类产品需求增加，公司该类产品具有较强市场竞争力，可获得更高市场份额，为公司提供新的业绩增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 18 日